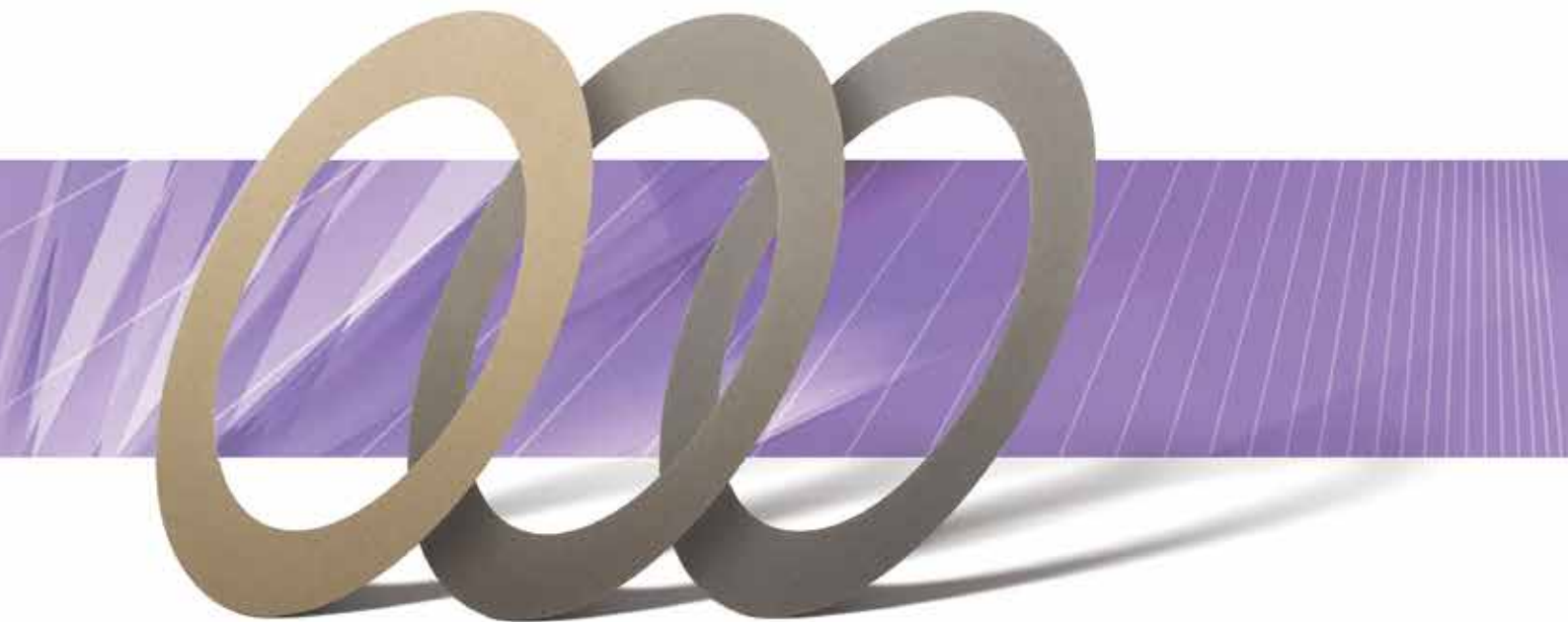
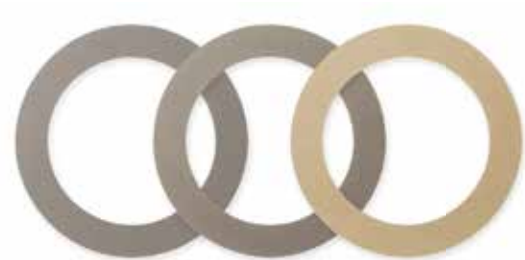
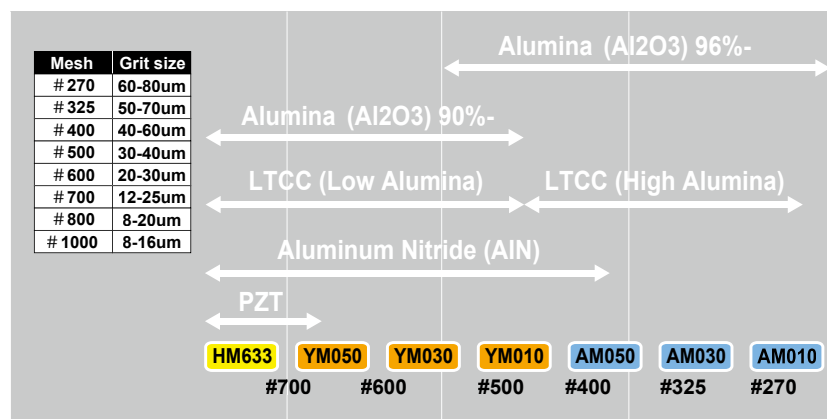


PRECISION ACCRETECH BLADE
METAL BOND BLADES
セラミック用 メタルブレード
YM/AMシリーズ



**高純度セラミックスも切断可能なメタルブレードシリーズ。
 長寿命化を実現します。**

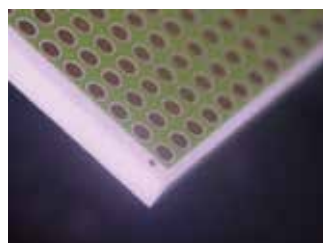


■加工例 AMシリーズ

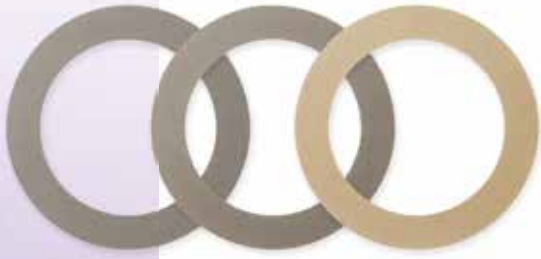


■ アルミナ基板LEDの切断
 従来のメタルブレードでは切味が低下し個片化時にプロトリューションが発生していましたが、AMシリーズでは切味がよく垂直に切断可能となりました。

■加工例 YMシリーズ



■ LTCCの切断
 厚いLTCCに対しても切れ味の改善によりチッピング、欠けが発生することなく切断が可能となりました。
 YM030使用。



仕様と表示方法

1A8

形状

MD

砥粒

400

砥粒径

50

集中度

AM030

結合材

砥粒

MD	標準砥粒
XD	コーティング砥粒

集中度

25, 50, 75, 100

寸法と表示方法

56D

外径

0.2T

刃厚

40H

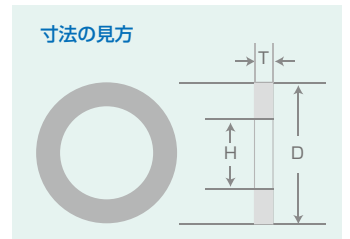
内径

寸法規格

外径D(mm) 公差+0.1/-0	刃厚T(mm) 公差±0.005 *1	内径H(mm) 公差H6, H7
50≤D≤62	0.05≤T≤0.4	40

*1 #325は±0.01

寸法の見方



粒度による製造可能タイプ

粒度	砥粒	
	MD	XD
4000	●	
2500	●	
2000	●	●
1300	●	●
1200	●	●
1000	●	●
800	●	●
700	●	●
600	●	●
500	●	●
400	●	●
325	●	●

粒度による製造可能刃厚

粒度	刃厚(mm)				
	0.05~ <0.08	0.08~ <0.1	0.1~ <0.15	0.15~ ≤0.25	0.25~ ≤0.4
4000	●	●	●	●	●
2500	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●
1300	●	●	●	●	●
1200		●	●	●	●
1000		●	●	●	●
800		●	●	●	●
700		●	●	●	●
600		●	●	●	●
500		●	●	●	●
400		●	●	●	●
325		●	●	●	●

結合材

YM010	軟らかめ
YM030	標準
YM050	硬め

YMシリーズ セラミック全般

AM030	標準
AM050	硬め

AMシリーズ アルミナ向け

ご注文に際して

ご注文にあたっては、当社カタログを参考に下記の項目について出来るだけ詳しくお知らせ下さい。

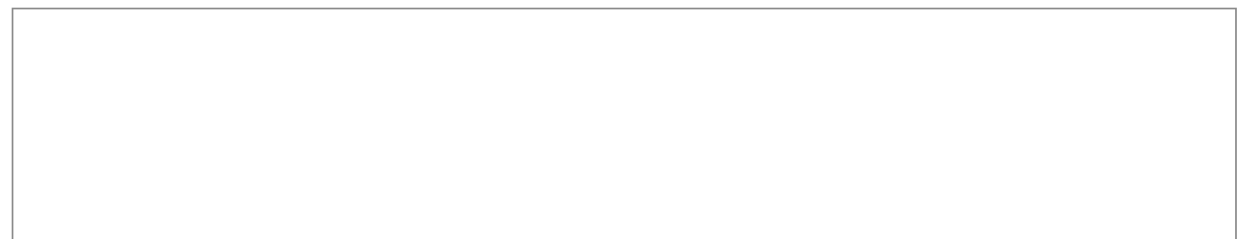
- 1) 形状、寸法 / 具体的ブレード形状とご要求精度等
- 2) 仕様 / ご希望の弊社仕様、現在ご使用中の製品の使用等
- 3) 切断ワーク・切断条件 / 使用機器、回転数、送り速度、クーラント流量等

ご使用に際して

安全に使用していただくために、またブレードの性能を十分に引き出すために、ご使用前に製品に添付されている取り扱い説明書及び検査票の記載事項、加工機取り扱い説明書を良くお読みの上ご使用下さい。

※本カタログは予告なく変更することがあります。

※本カタログは製品性能を保証するものではありません。



株式会社東京精密